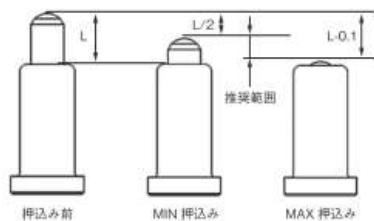


## 製品ガイドライン

### ■ 嵌合公差について (ピン押し込み方向)

ピンの押し込み量の推奨範囲は以下の通りです。

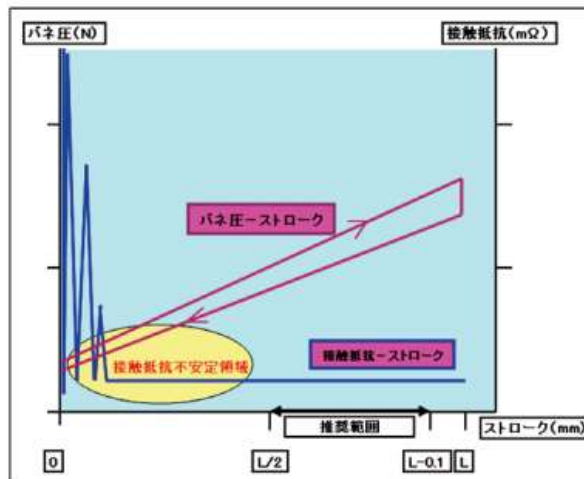
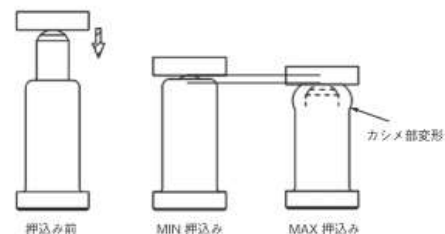


#### ■ MIN 押し込み

ピンは出寸法 (Lmm) の半分以上押し込んでください。押し込み不足の場合、接触抵抗が不安定となる場合があります。

#### ■ MAX 押し込み

ピンの押し込み過ぎに注意してください。チューブカシメ部が変形し、スタックの原因となります。

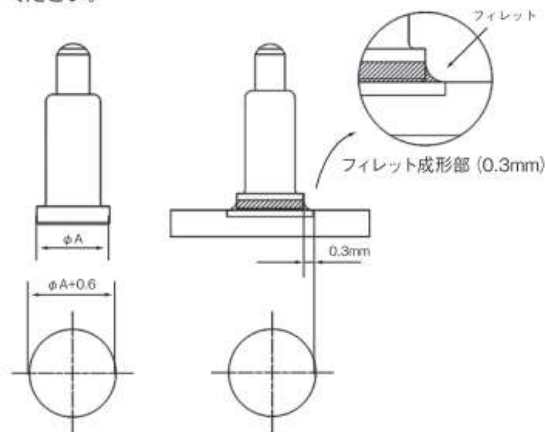


### ■ 推奨ランドパターンについて

推奨ランドパターンの仕様は以下の通りです。

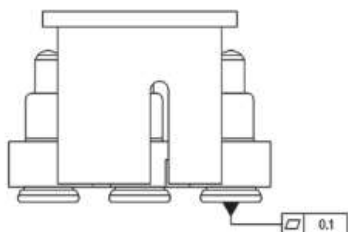
#### ■ 推奨ランドパターン

半田強度を確保するため、フィレット形成に必要な部分を設けてください。



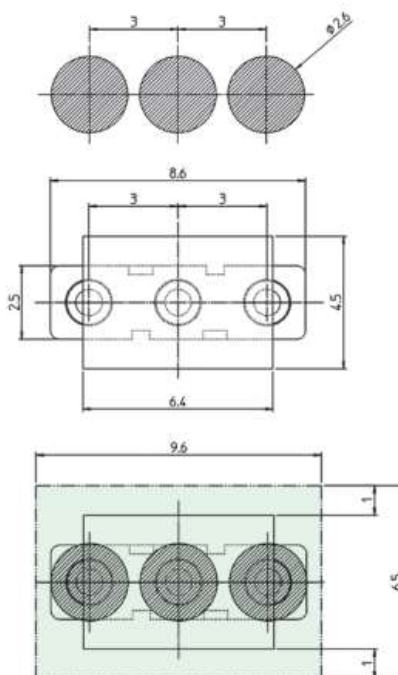
#### ■ メタルマスク厚

製品の端子部平坦度 (コプラナリティ) は MAX0.1 です。メタルマスク厚は 0.1mm 以上としてください。



#### ■ 実装エリア

キャップ付き製品のため、キャップ外形およびキャップを取るための作業エリアとして、隣部品と干渉しないように十分な実装エリアを設けてください。



## 製品ガイドライン

### ■ 相手端子について

推奨する相手端子は以下の通りです。

#### ■ 相手端子の外形

製品の接点ズレ、実装時のズレ、嵌合時のズレを考慮し、相手端子の大きさは  $\phi 2\text{mm}$  以上としてください。

接点ズレ = 製品ピッチ公差 (0.1mm) + ピン振れ (0.2mm) + 部品公差 (0.05mm)

実装ズレ = 0.3mm

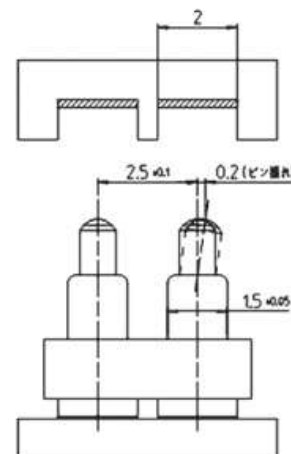
嵌合ズレ = 0.3mm

#### ■ 相手端子の材質、粗さ、硬度について

相手端子の材質は、黄銅板、銅合金板又は基板を推奨とし、接触面は平滑で金メッキとしてください。

#### ■ 相手端子のメッキ仕様

相手端子のメッキ仕様は、SPC 製品のピンのメッキ仕様と同等である「ニッケルメッキ下地 / 金メッキ  $1\mu\text{m}$  以上」が推奨です。

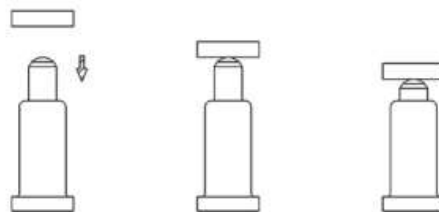


### ■ 相手端子との嵌合方法について

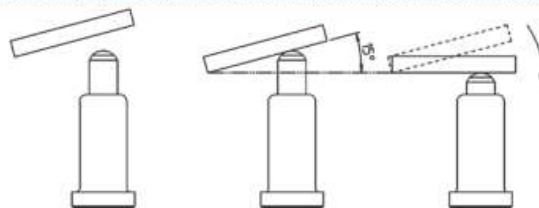
SPCを相手端子と嵌合する場合は、以下のことにご注意願います。

#### ■ 嵌合方法

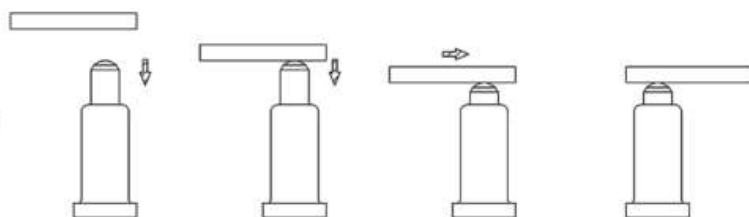
相手端子を嵌合する場合は、必ず垂直に押し込んでください。SPCの側面から嵌合した場合、SPCが変形し接触抵抗不良の原因となります。



斜めから嵌合する場合は、当たり角度を  $15^\circ$  未満に設定し、嵌合回数は 2,000 回以内としてください。



スライド嵌合はしないで下さい。ピン先端のメッキ削れが発生し、接触抵抗不良の原因となります。



#### ■ 相手端子との許容角度

相手端子とは SPC の軸に対して  $5^\circ$  以内で使用してください。

